

フレキシブル基板用ファインパターン対応

無電解ニッケル／金めっきプロセス

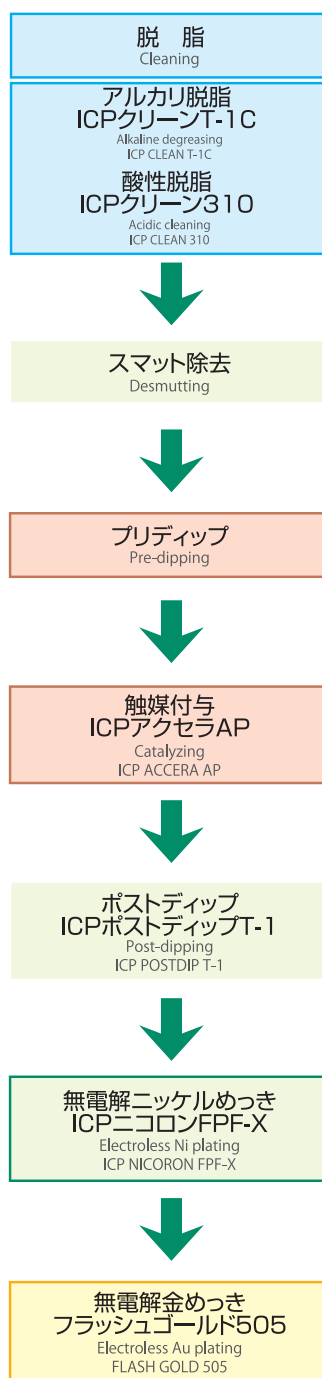
To flexible printed circuits for fine patterns

Electroless Ni/Au plating process

- 耐折性が良好で、フレキシブル基板に最適
 - ファインパターン性に優れ、微細配線へのめっきにも対応
 - レジスト残渣などの除去性に優れ、均一なめっき外観が得られる
- Excellent in folding endurance, best for FPC boards
 • Excellent in fine patterning performance, applicable to ultra-micro patterning
 • Can remove remaining resist strongly, can obtain uniform plating appearance

処理工程

Process



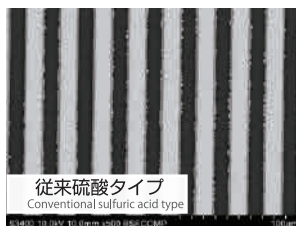
塩化物フリー低濃度触媒付与液

Chloride-free, low-concentration catalyzing solution

- パラジウムの低濃度化 (Pd: 20 mg/L)
- 銅溶解量が低く、長期使用が可能
- Low palladium concentration (Pd:20mg/L)
- Copper dissolution amount is small, long bath life is possible

優れたファインパターン性

Excellent fine circuit pattern ability



※L/S=15/25 μ m

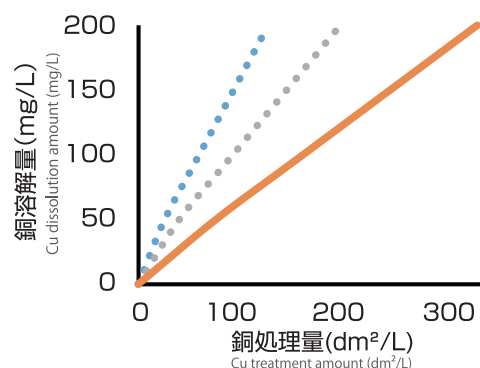
無電解ニッケルめっき:3 μ m

※L/S=15/25 μ m

Electroless nickel plating:3 μ m

低い銅溶解量

Copper dissolution amount: small



- 従来塩酸タイプ
Conventional hydrochloric acid type
- 従来硫酸タイプ
Conventional sulfuric acid type
- ICPアクセラAP
ICP ACCERA AP

レジスト残渣除去に優れる脱脂液

Cleaner to remove remaining resist strongly

- 微エッチングタイプ
- 銅表面上の汚れや酸化皮膜の除去に優れる
- Micro-etching type
- Can remove dirt and oxidized layers on copper strongly

優れた洗浄効果

Excellent in cleaning effect

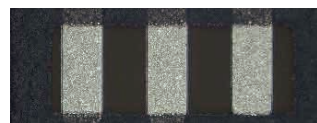
めっき処理前

Before plating



めっき処理後

After plating



ICPクリーン310
ICP CLEAN 310

従来浴
Conventional bath